

LG이노텍, LED 투자 100% 확대

8000억원 투입 파주 생산라인 구축 ... 광주공장은 웨이퍼·칩 증설

LG이노텍이 2010년 1조1000억원을 투자키로 하고 LED(Light Emitting Diode) 투자는 2배 확대할 방침이라고 밝혔다.

LG이노텍은 전 부문에 걸쳐 글로벌 수준의 경쟁역량을 확보한다는 방침에 따라 전년대비 110% 이상 늘어난 1조1000억원을 투자하고 14% 증가한 4조원의 매출을 달성하는 내용의 경영목표를 발표했다.

2009년 연결기준 매출 3조5000억원(LG마이크론 합병 전 상반기 매출 포함), 영업이익 1776억원의 사상 최고 실적을 올린 LG이노텍은 2010년 통합 시너지 효과와 LED를 비롯한 핵심사업의 본격 성장으로 매출 4조원의 목표를 제시했다.

특히, 주력사업인 LED에 2009년보다 2배 늘어난 8000여억원을 투자해 파주 첨단소재단지 LED 패키지 생산라인을 구축하고 광주공장 LED 에피웨이퍼·칩 생산라인을 확충키로 했다. 7월에 파주 소재 LED 생산라인이 본격 가동되면 패키지생산량이 4배 이상 늘어날 전망이다.

또 LED 광효율을 개선하고 고효율 수직형 LED칩 적용을 늘려 LCD(Liquid Crystal Display) TV용 LED BLU(백라이트유닛)의 원가경쟁력을 강화한다는 방침이다.

2012년까지 LED 사업에서만 매출액 1조5000억원을 달성하고 LED 패키지 기준 세계시장 점유율을 10% 확보한다는 목표를 세웠다.

아울러 고부가가치사업의 비중을 늘리고 핵심기술을 확보하는 등 사업구조 고도화에도 힘을 쏟기로 했다.

LED, PCB(인쇄회로기판) 등 고부가가치 소재·소자사업 비중을 40%에서 60%까지 늘리고 튜너, 테이프 서브스트레이트 등 세계 1위 사업의 매출비중을 30%에서 45%까지 확대할 계획이다.

또 반도체 기판 사업을 강화하기 위해 구미공장에 950억원을 투자해 첨단 반도체 패키지인 플립 칩(Flip Chip) CSP(Chip Scale Package) 생산설비를 확충하기로 했다.

플립 칩 CSP는 반도체 칩을 회로 기판에 부착시킬 때 칩 아랫면의 전극 패터를 이용해 그대로 용착하는 패키지로, 소형, 경량화, 고정밀화가 유리한 장점이 있다.

LG이노텍은 2010년부터 추진하는 사업구조 고도화와 핵심·원천기술 확보를 바탕으로 2015년까지 매출 8조원에 영업이익률 10%를 달성해 명실상부한 글로벌 전문 부품기업으로 거듭난다는 방침이다. <저작권자 연합 뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2010/01/25>